

株式会社ジェイ・イー・ティ

2025年12月期
第3四半期決算説明資料

2025年11月7日

The background of the slide is a complex, abstract illustration of a circuit board. It features a dense network of blue lines representing traces, with various components like chips and connectors depicted in a stylized, glowing manner. The overall color palette is shades of blue, ranging from deep navy to bright cyan.

2025年12月期第3四半期 連結決算概要 通期予想

日本向け洗浄装置の売上は来期売上に延期
中国市場での利益率低い装置の計上や、受注したが納入時期が明確でない製品の
棚卸評価損の計上、繰延税金資産の取り崩しにより厳しい決算に

売上高 11,021百万円 前期比 $\triangle 22.9\%$	営業利益 $\triangle 1,704$ 百万円 前年同期実績 755百万円	経常利益 $\triangle 1,781$ 百万円 前年同期実績 688百万円	当期純利益 $\triangle 2,541$ 百万円 前年同期実績 403百万円
---	--	--	---

- ✓ 米国の関税政策の影響、中国の不動産不況に伴う景気低迷の継続など世界経済は依然、不確実性の高い環境下で推移
- ✓ エレクトロニクス製品の世界的な消費停滞は継続、特に中国市場ではここ数年間の成熟世代半導体向け新規設備投資増強の影響を受け、ファウンドリの設備稼働率は停滞
- ✓ メモリーはDRAM及びNANDフラッシュの価格は緩やかに上昇、AIサーバー向けGPUとHBMの需要は引き続き旺盛、投資も継続

連結業績

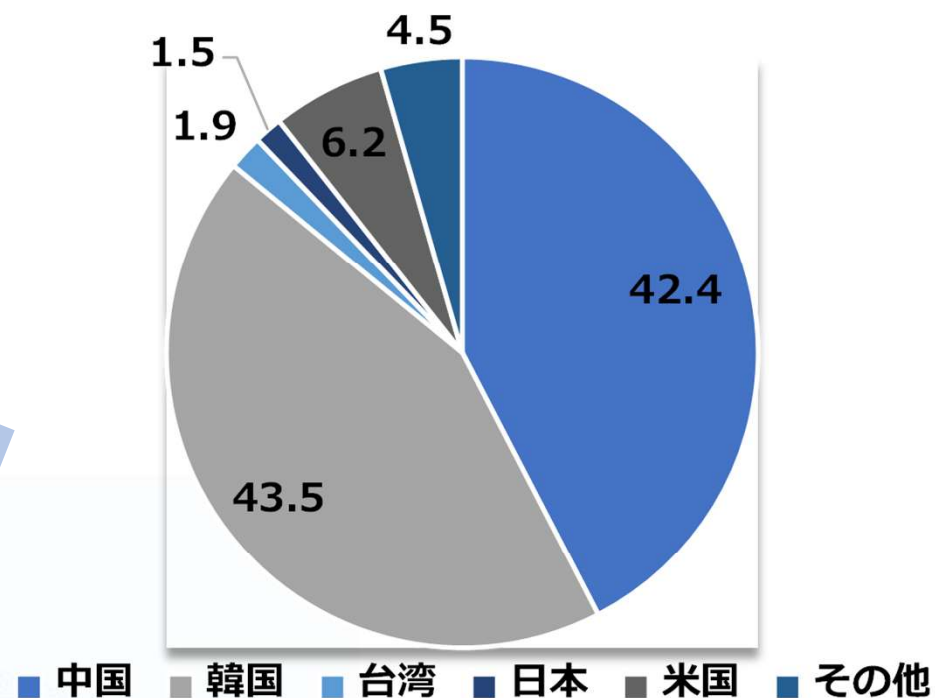
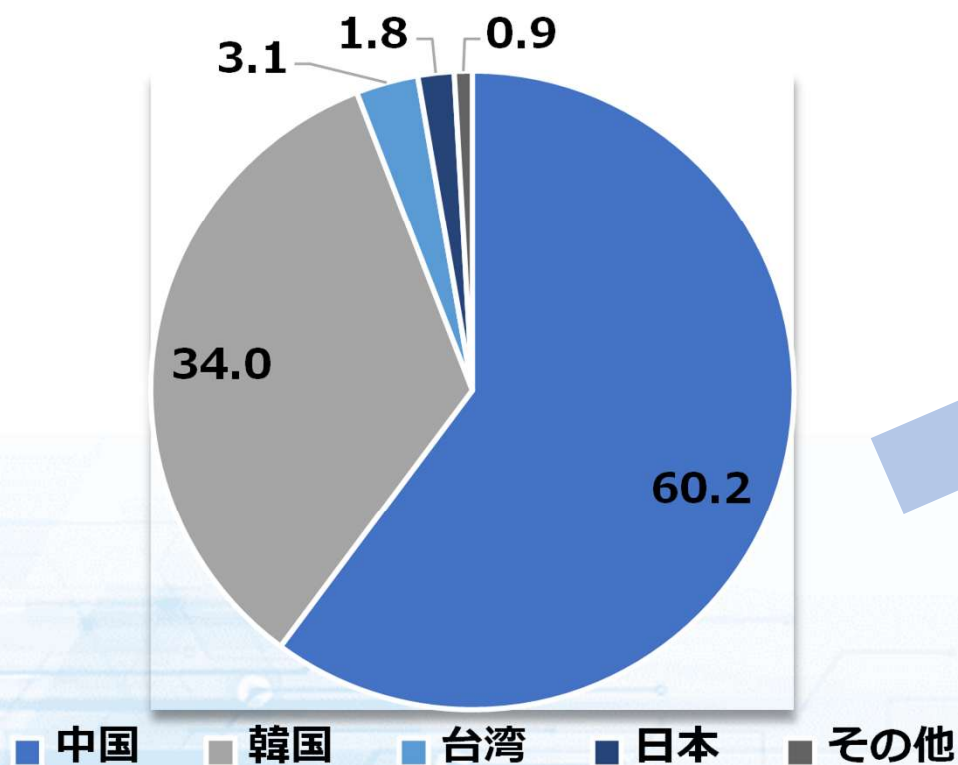


単位（百万円）	2024年3Q	売上比（%）	2025年3Q	売上比（%）	対前期比（%）	通期予想	進捗率（%）
売上高	14,291	—	11,021	—	△22.9%	13,420	82.1%
売上総利益	2,977	20.8%	313	2.8%	△89.5%		
販管費	2,221	15.5%	2,017	18.3%	△9.2%		
営業利益	755	5.3%	△1,704	—	—	△1,810	—
経常利益	688	4.8%	△1,781	—	—	△1,910	—
当期純利益	403	2.8%	△2,541	—	—	△2,750	—

単位未満切り捨て、比率は小数点以下第2位を四捨五入

- ✓ 売上高は前期比22.9%減収、売上の通期予想に対する進捗率は82.1%
- ✓ 引き続き販管費を抑制も、中国市場で国産メーカーとの競合で受注した案件、カスタマズ要素の多い新規案件など利益率低い装置の計上や製品の棚卸評価損の計上、繰延税金資産の取り崩しに伴う法人税等調整額の計上も加わり厳しい決算に

半導体事業 地域別売上高構成比推移



連結貸借対照表

単位（百万円）	2024年12月期	2025年3Q	増減	主な増減要因
流動資産	23,824	18,978	△4,846	「商品及び製品」及び「仕掛品」の減少
有形固定資産	831	792	△39	
無形固定資産	101	101	0	
投資その他資産	734	166	△568	
資産合計	25,491	20,039	△5,452	
流動負債	8,575	5,942	△2,633	「短期借入金」の減少
固定負債	4,446	4,285	△161	「長期借入金」の減少
負債合計	13,021	10,228	△2,793	
純資産合計	12,469	9,810	△2,659	「利益剰余金」の減少
負債純資産合計	25,491	20,039	△5,452	

単位未満切り捨て

マクロ環境については厳しい環境が続くも、生成AIの利用拡大、DXの進展などデータ社会への移行により改善もみられ、投資案件、提携案件の報道も増加傾向

- ✓ 米国の関税措置について日本、韓国、EUなど各国合意を受け落ち着きは出てきたものの、相応の税率が付されることが世界経済に与える影響は不透明
- ✓ 米中貿易摩擦や不動産不況に端を発する中国経済の停滞懸念は持続
- ✓ 車載や産業向けのレガシー半導体の需要は軟調ではあるが、緩やかに改善
- ✓ データ社会への移行が進む中、先端半導体のニーズは更に高まり、オープンAIの74兆円規模の「スターゲート」にサムスン電子やSKハイニックスが半導体供給で提携など、巨額の投資案件、提携案件の報道も多く見られる

2025年12月期通期業績予想

今期は赤字決算となるも、来期以降の黒字確保に向け対策を強化中

売上高 13,420百万円 前期比 △24.9%	営業利益 △1,810百万円 前期比 —	経常利益 △1,910百万円 前期比 —	当期純利益 △2,750百万円 前期比 —
---	---	---	--

- ✓ 中国ファウンドリ及びメモリーメーカーから受注を想定していた装置の投資計画が延期、上期に想定していた案件が受注に至らず売上高が大きく減少
- ✓ 中国市場での現地メーカーと競合の上受注した利益率低い装置の売上計上
- ✓ 受注したが納入時期が明確でない製品在庫の棚卸評価損13億40百万円の計上、部品在庫2億円の棚卸評価損の計上
- ✓ 繰延税金資産の取り崩しに伴う7億60百万円の法人税調整額の計上

2025年12月期第3 四半期 TOPICS

- 9月7日 NHKスペシャル「1兆円を託された男～ニッポン半導体 復活のシナリオ」に当社代表取締役CEO房野正幸及び当社エンジニアへのインタビュー、最新の製品が紹介される
- 9月19日 中国での当社連結子会社 欧利白科技（上海）有限公司が、2025年7月29日付で設立された新必思半導体科技（南通）有限公司へ持分比率24.0%の出資を行い、持分法適用関連会社とすることを取締役会で決議

中国市場の現状と新必思半導体科技への出資の狙い①

中国市場の現状

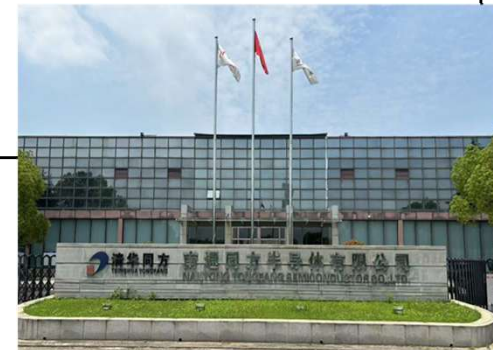


- 当社装置の既納入先において国策を背景に中国国産装置による置換が進行
- 中国現地メーカーもバッチ式において技術力向上
- 現地メーカーと技術的な差別化を図った戦略機種BW3500も、国産品優先の流れのなか主要顧客も導入の前向きな検討が困難な状況
- 10月23日に閉幕した中国共産党の4中全会で示された第15次5か年計画（2026～2030）でも、「科学技術の自立自強の水準を大幅に高める」方向が示唆され、半導体製造装置についても業界団体が現状25%程度の国産比率を70%まで引き上げる目標が掲げられている

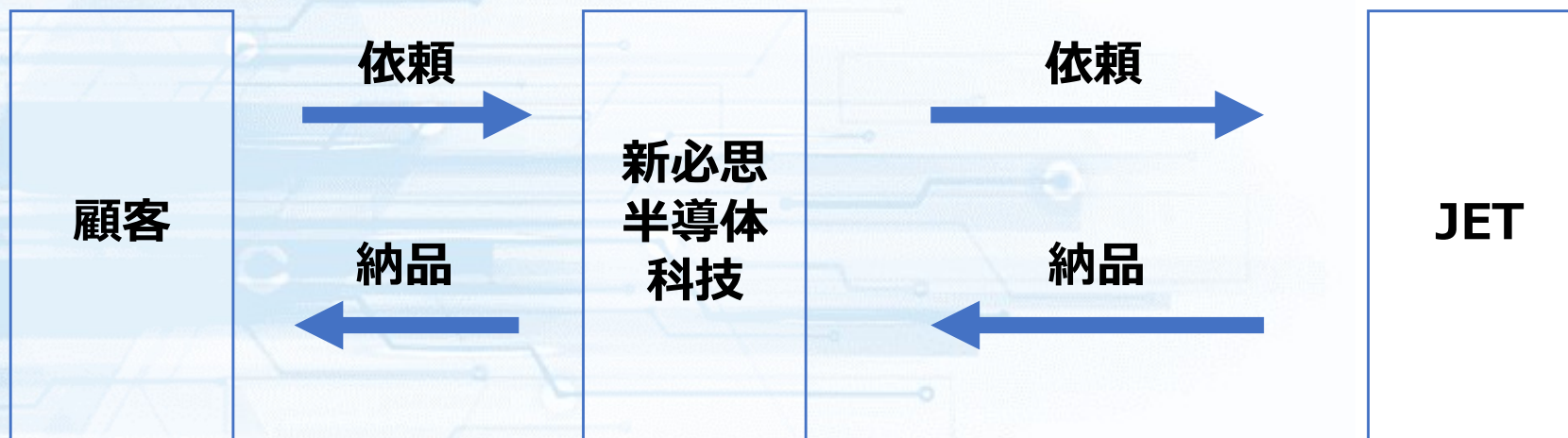
中国市場の現状と新必思半導体科技への出資の狙い②

出資の狙い

- 国産化の流れのなかで、まさに中国現地メーカーである新必思半導体科技を通じ、中国市場での継続した売上を図りJET本社の収益基盤強化に貢献する
- 本件をSTEP1として、更に現地化を進める方策を検討する



商流



ビジネスモデル概要

基本方針

中国国内市場を中心に、「国産化」を掲げた装置置換を推進

他社の既存輸入装置をターゲットに代替提案

価格競争力・納期対応・現地サービス体制で差別化

事業領域

半導体製造装置（洗浄装置）の開発・製造

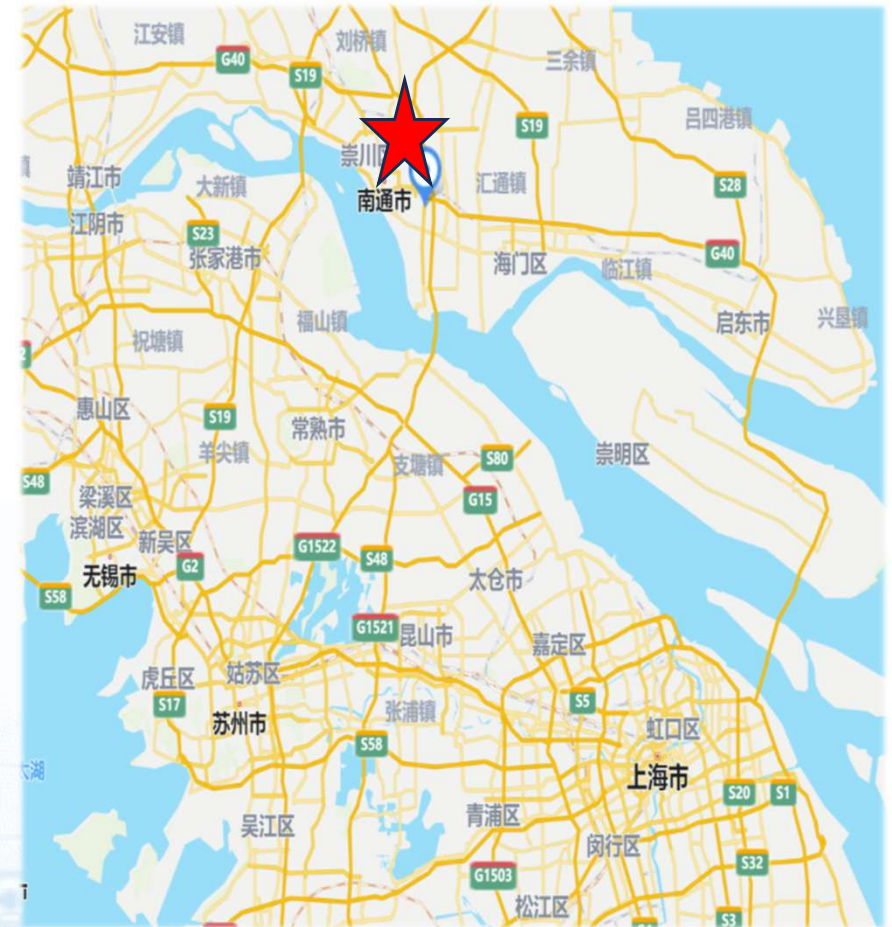
主力製品：BW3500

補完製品：BW3000

ターゲット顧客

中国内の半導体ファブ（先端・中堅層）

特に、SMIC、YMTC、CX Gr.、HH Gr.



南通市（所在地・工場候補地）

Appendix

会社概要

半導体洗浄装置の開発・製造・販売・アフターサービスを展開



リーマン・ショック後の半導体不況時に民事再生手続を開始し、その後破産手続に移行したエス・イー・エス(株)が前身同社の卓越した半導体洗浄装置に関する技術を継承すべく、販売代理店であった韓国企業のZEUS CO., LTD.（以下、「ZEUS」）の全額出資のもと、2009.4.24に設立、2009.5にエス・イー・エス(株)の岡山工場等を事業譲渡により引き継ぎ誕生

■会社概要

会社名	株式会社ジェイ・イー・ティ
-----	---------------

英訳名	J.E.T. Co., LTD.
-----	------------------

設立	2009年4月
----	---------

資本金	1,848百万円（2024年12月31日時点）
-----	-------------------------

所在地	岡山県浅口郡里庄町新庄金山6078番
T E L	0865-69-4080

代表者	代表取締役 CEO 房野 正幸
-----	-----------------

従業員数	163名
従業員数	279名 ※連結会社含む全従業員数 (2025年6月30日時点)

事業内容	半導体洗浄装置の開発・製造・販売・アフターサービス等
------	----------------------------

主要納入先	サムスン電子（韓国）SMIC（中国）
-------	--------------------

グループ関係図

親会社ZEUSとは事業の棲み分けがなされ、競合関係もなく、経営についても役職員の出向等の受け入れを廃止し独立性の確保を図る



所在地： 大韓民国
京畿道華城市

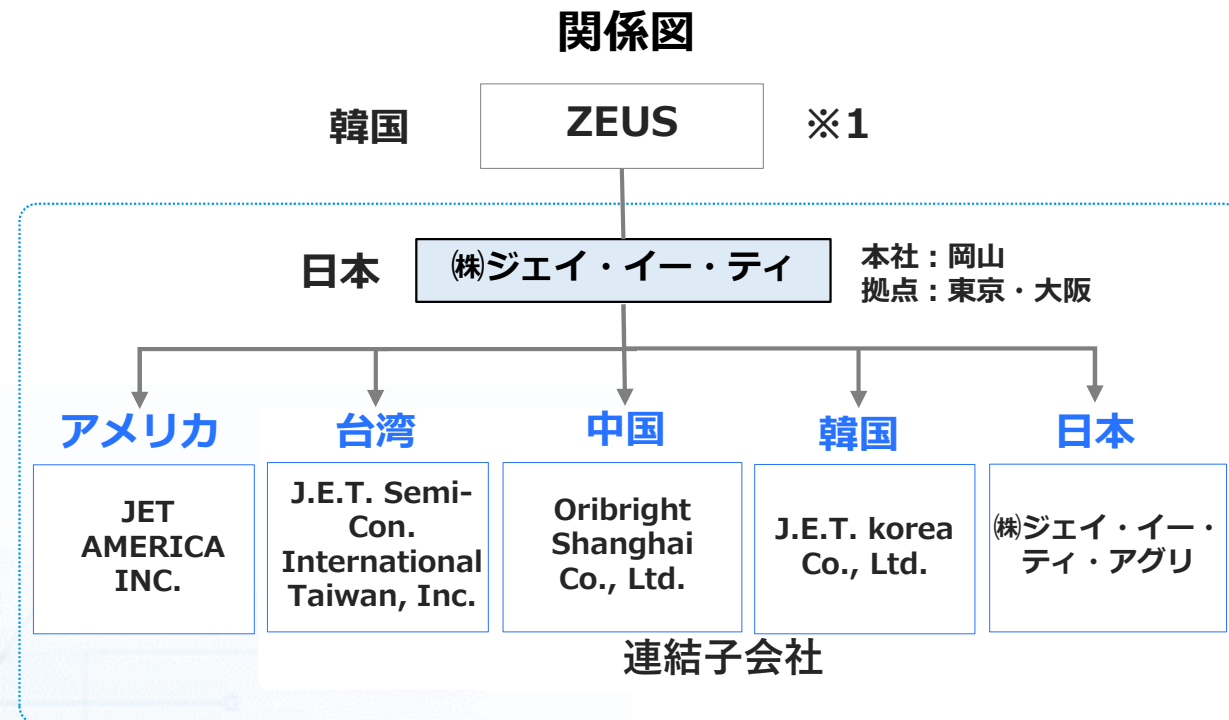
資本金： 15,530,995千KRW

事業の内容： 半導体・液晶用各種製造装置の製造・販売

当社の議決権の保有割合(%)： 66.3%（直接）

関連当事者との関係： 営業取引

取引の内容： 双方より部品・材料等の販売・仕入及び装置製造業務委託、当社よりZEUSへ販売手数料支払い等



※1 韓国取引所KOSDAQに上場

* 2022年4月末までは、当社にてZEUSより非常勤取締役1名を受け入れていたが、2022年5月以降、ZEUSから当社への役職員の出向等による受け入れは行っていない。

■ 国内拠点
■ 海外拠点



韓国拠点 19名

J.E.T. korea Co., Ltd.

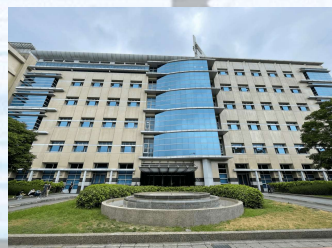
Oribright Shanghai Co., Ltd. 北京事務所
Oribright Shanghai Co., Ltd. 無錫事務所
Oribright Shanghai Co., Ltd. 合肥事務所
Oribright Shanghai Co., Ltd. 西安事務所
Oribright Shanghai Co., Ltd. 広州事務所
Oribright Shanghai Co., Ltd. 上海本社



中国拠点 69名

* 中国拠点については、一部の事務所の掲載を省略しております。

J.E.T. Semi-Con. International Taiwan, Inc.
(HEAD Office) 台湾本社



台湾拠点 21名

J.E.T. Semi-Con. International Taiwan, Inc.
(Singapore branch) シンガポール支社

シンガポール 3名

大阪事務所(※2)

東京事務所(※1)

九州出張所(※1)

(株)ジェイ・イー・ティ

- 本社
- 笠岡ファーム(※1)

本社 (岡山)



- ※1 東京事務所及び九州出張所では、当社顧客へのフィールドサービスを提供。
- ※2 大阪事務所は、LIB製品の営業を担当。
- ※3 笠岡ファームでは、当社連結子会社(株)ジェイ・イー・ティ・アグリがトマトを栽培。



JET AMERICA INC.

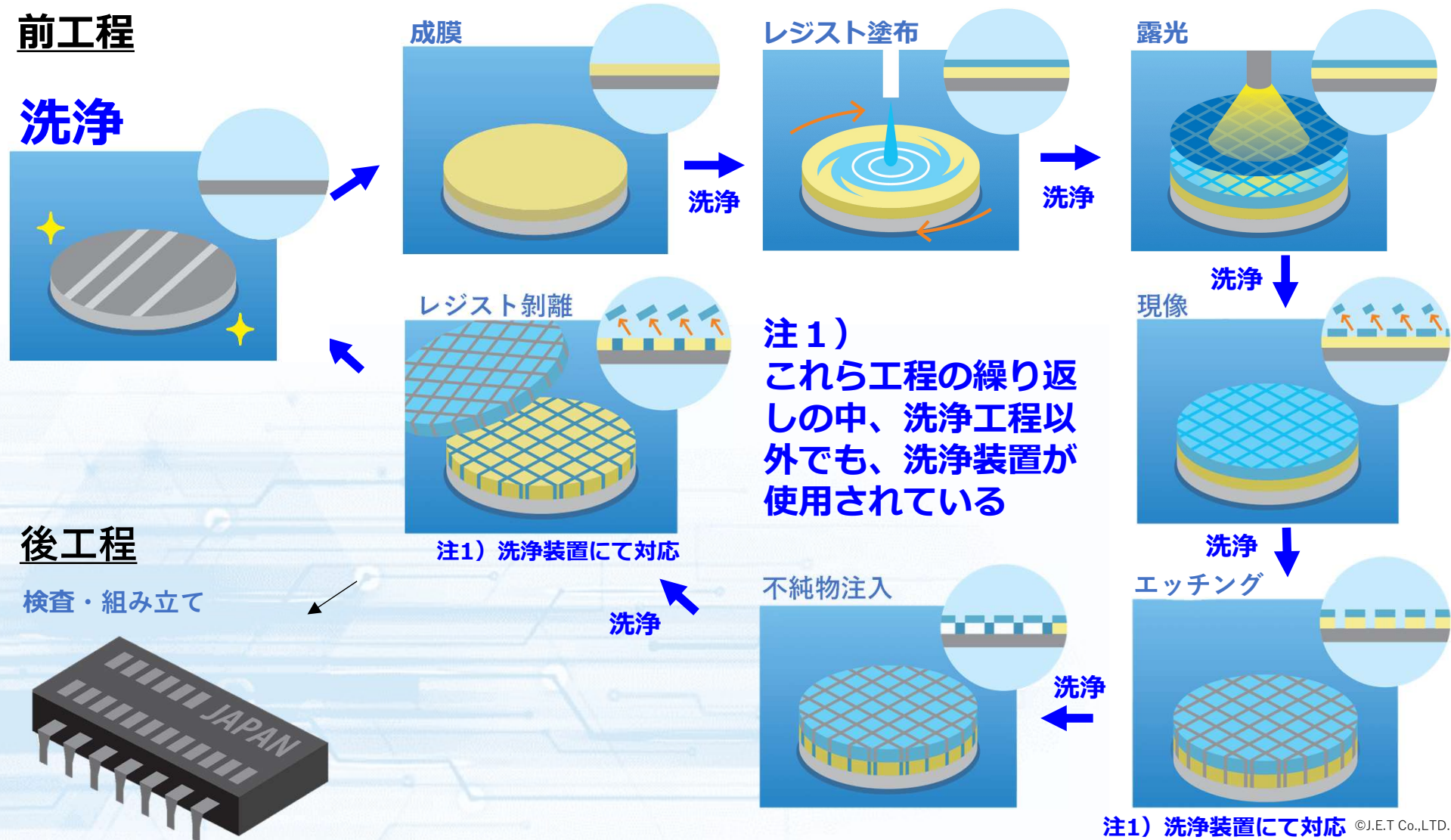
米国拠点 4名

半導体製造プロセス 前工程

半導体製造プロセス前工程（500工程以上）において、洗浄は極めて重要な工程
前工程の30~40%（工程数ベース）が洗浄装置を使用する工程と考えられている

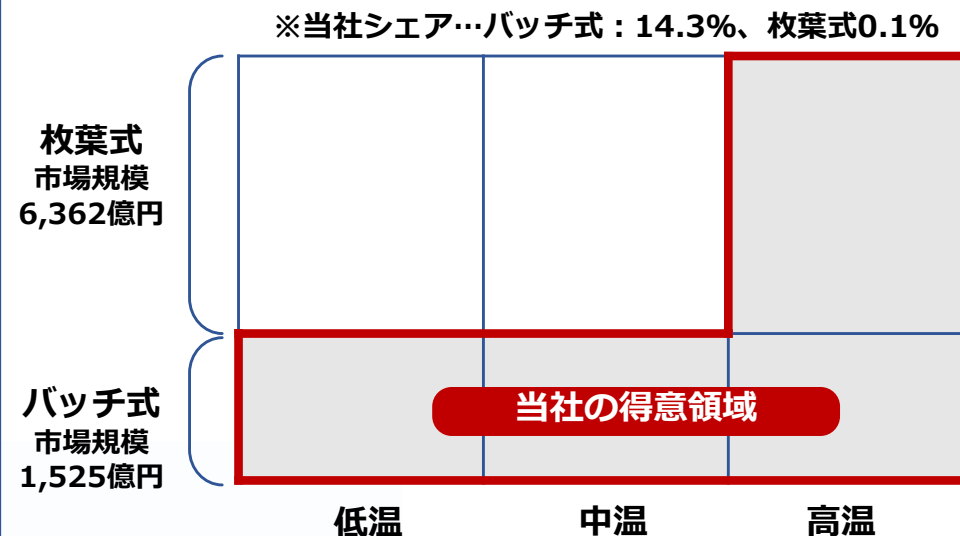
前工程

洗浄



半導体洗浄装置 バッチ式と枚葉式：当社の得意領域

		バッチ式洗浄装置	枚葉式洗浄装置
概要		25～50枚のウエハを一括洗浄	ウエハを1枚ずつ洗浄
長所		生産性が高い	精密な洗浄が可能
短所		ウエハの塵を拾い易い	生産性が低い
現状		生産性の優位性から一定のシェアを堅持	現在の主流洗浄装置
高温高粘度処理	特徴	プロセス温度維持が容易	プロセス温度維持が難しい
	硫酸	○（主流）	△（一部対応）
	リン酸	○（主流）	△（一部対応）
市場規模（2023/世界）		1,525億円 （当社シェア 14.3%）	6,362億円 （当社シェア 0.1%）



競合状況と差別化要素

半導体洗浄装置は、2000年代以降日本企業が70%以上のシェアを持つと考えられており、特にA社、B社の存在感が大きい

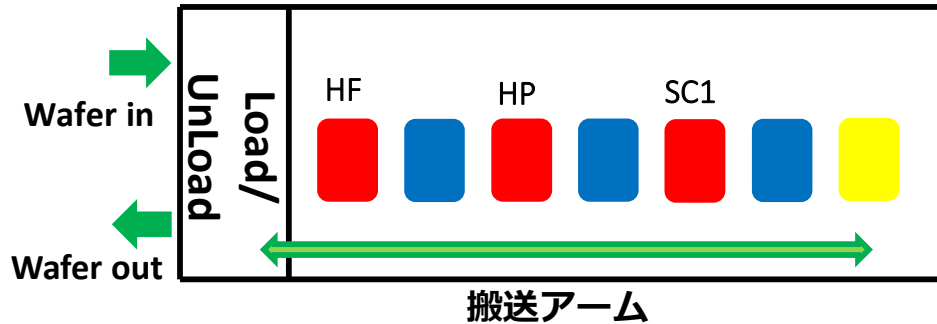
		当社	A社	B社
会社規模 (2023年度 売上高/営業利益)		250億円 (26億円)	5,049億円 (941億円)	1兆8,305億円 (4,562億円)
シェア (2023年度の 市場規模)	バッチ式 (1,525億円)	14.3% (218億円)	49.3% (752億円)	21.6% (329億円)
	枚葉式 (6,362億円)	0.1% (4億円)	47.3% (3,007億円)	20.7% (1,318億円)
技術	RCA洗浄	△	◎	○
	硫酸洗浄	◎	○	△
	リン酸洗浄	◎	○	△
	その他	○	△	○
生産能力		△ (量産能力は低い)	◎ (量産能力あり)	◎ (量産能力あり)
カスタマイズ性		◎ (カスタマイズ性に強み)	△ (標準化装置に強み)	△ (標準化装置に強み)

(出所) 経済産業省「令和5年6月 半導体・デジタル産業戦略」より、評価は当社独自の認識

- 当社の競合他社は、売上規模が数千億円～数兆円の大企業で、高品質で標準化した装置を量産できる点が強み
- 当社は量産能力に劣るものの、難易度の高い高温高粘度処理やカスタマイズ性の高さに強みがある
大企業が参入しづらいニッチ領域へ、小回りの利く当社が参入し、シェアを獲得している状況

JETバッチ装置の優位性⇒ 唯一F-Typeを持つ

I-Type A社 / B社 / 当社

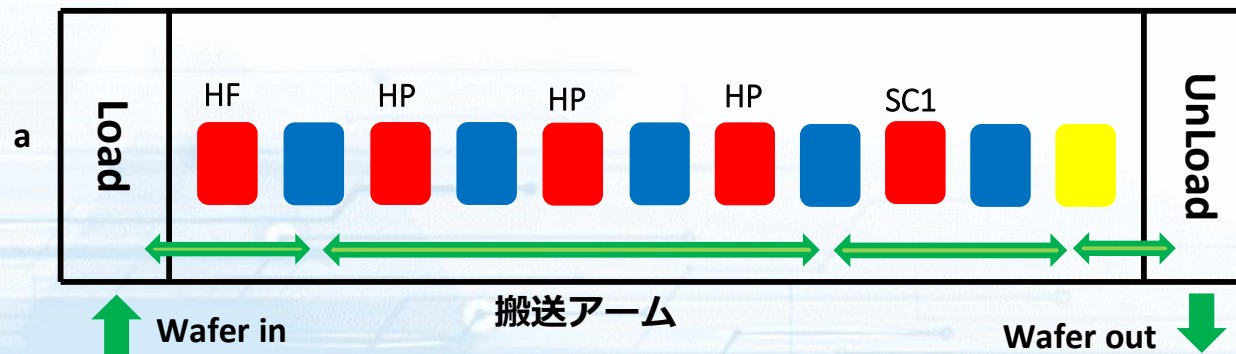


 ケミカル槽
 水洗槽
 乾燥機

特徴

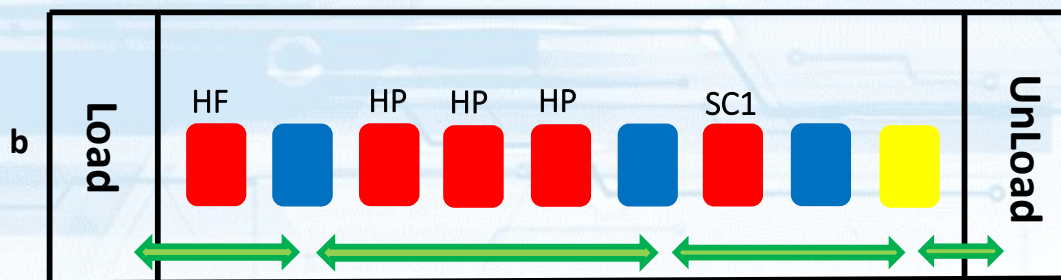
- ・ コンパクト
- ・ 処理槽 MAX 8 槽
(アームが左右に動き、渋滞が発生する為)
- ・ スループット 最大250w/h

F-Type 当社のみ



特徴

- ・ 少し大きい
- ・ 処理槽 MAX14槽
(アームが一方通行で、渋滞なしの為)
- ・ a/b 選択可能
- ・ bはケミカル槽を連続配置可能
- ・ 高温の硫酸・リン酸洗浄に多用
- ・ スループット 最大 500w/h



* 2023年12月時点での当社独自の認識による。

	BW3000	BW3700
		
洗浄方式	バッチ式洗浄装置 300mmウエハ対応	バッチ式洗浄装置 300mmウエハ対応
特徴	◎顧客要求に応えるフレキシブルな構成（洗浄槽の配列、数量を任意に対応可能） ◎生産効率の向上 ◎500WPHに対応する高速LD/ULD ◎装置設置面積が小さく、工場内への設置数を増やすことが可能 ◎二酸化炭素の低減 ◎気体流量のコントロールを実現 ◎標準化仕様化を進め、立上タイム短縮 ◎SEMI standardに対応 ◎EES（EDA or TDI）に対応	◎装置設置面積が小さく、工場内への設置数を増やすことが可能 ◎排気システムの個別配管により各処理槽の処理能力を安定化 ◎ウエハ間ピッチ7mm処理の実現 ◎ウエハの接触部の縮小化の実現によるパーティクル（微細なゴミ）の発生を減少 ◎気泡発生の低減化を実現 ◎リバースフローシステムにより液置換効率を向上 ◎濃度の安定性を向上 ◎豊富な処理槽種類に対応 ◎1薬液プラス1DIW構成に対応
価格帯 (平均単価) (百万円)	210~400	320~560

当社主要製品②

	BW2000	HTS-300
		
洗浄方式	バッチ式洗浄装置 200mmウエハ対応	枚葉式洗浄装置 300mmウエハ対応
特徴	◎ 高い生産効率 ◎ 高い洗浄能力 ◎ 省フットプリント ◎ 顧客要求に応えるフレキシブルな構成（処理槽の構成、数量の変更に対応）	◎ 最小150ccの薬液消費量での処理を実現 ◎ 最高240℃での高温処理を実現 ◎ 最短30秒でのストリップ処理を実現 ◎ ウエハ反転処理によるヒューム（薬液の蒸気）拡散防止の実現
価格帯 （平均単価） （百万円）	150～210	330～540

当社主要製品③ BW3500

主力機種BW3000が開発から20年を経過、より顧客ニーズに応えられる後継機種として、BW3500を開発

- 今後投資の中心になる28nm以上のプロセスをターゲットに
- RCA洗浄の他社製品からの切替を意識

BW3000からの改善点

1. フットプリントの削減
(装置面積にて15～16%、装置全長で20%の削減)
2. 新たな搬送方式の採用
(搬送アームに加え、Moving/Single Lifterによる搬送)
3. 環境・安全対策
(OHT専用PORTの設置、薬液雰囲気漏れ軽減の機密性向上)
4. 破損防止対策(樹脂槽の採用)
5. 操作性向上(操作画面の大型化、カラー化、情報量アップ)

ほか、ONE BATH、メタルイオン対策、新排気システム、薬液使用量削減、スループット向上、新乾燥システムの採用などを実現



BW3500

当社 枚葉式装置のプロセス種類

薬液種類	JET装置	イメージ	機能と性能
SPM(H₂SO₄) 高ドーズインプラント後のレジスト除去 P-SiNドライエッチング後のレジスト除去	HTS HTS-300		薬液使用量の削減 ・プロセス時間の大幅短縮により薬液使用量は他社の20分の1にまで削減 ・ヒータによる温度制御によって高いレジスト除去性能を実現 効率的な処理が可能に ・除去したレジストは重力で落下するため、パーティクル軽減
O₃ GAS 高ドーズインプラント後のレジスト除去 P-SiNドライエッチング後のレジスト除去	EcO₃ OMR-3000		環境への負荷が少なく、ランニングコストも低い ・枚様式SPM装置の構造を生かし、O₃ GASでの処理を実現 ・O₃ GASを使用することで環境負荷を軽減しながらSPM同様のプロセスが可能 ・酸とアルカリによる反応生成物が形成されないため、1つの処理モジュールでSC1処理可能
HP(H₃PO₄) Front side SiN除去	Rush HPR-3000		枚葉装置初の高温高エッチングレート処理 ・JETの特許技術を活用し、最先端の窒化膜処理を枚葉式装置で実現 ・高いウェハ均一性を実現 ・高温維持により、高いエッチングレートを実現
HP(H₃PO₄) Back side SiN除去	Rush HBE-3000		

サステナビリティ経営方針

株式会社ジェイ・イー・ティ サステナビリティ経営方針

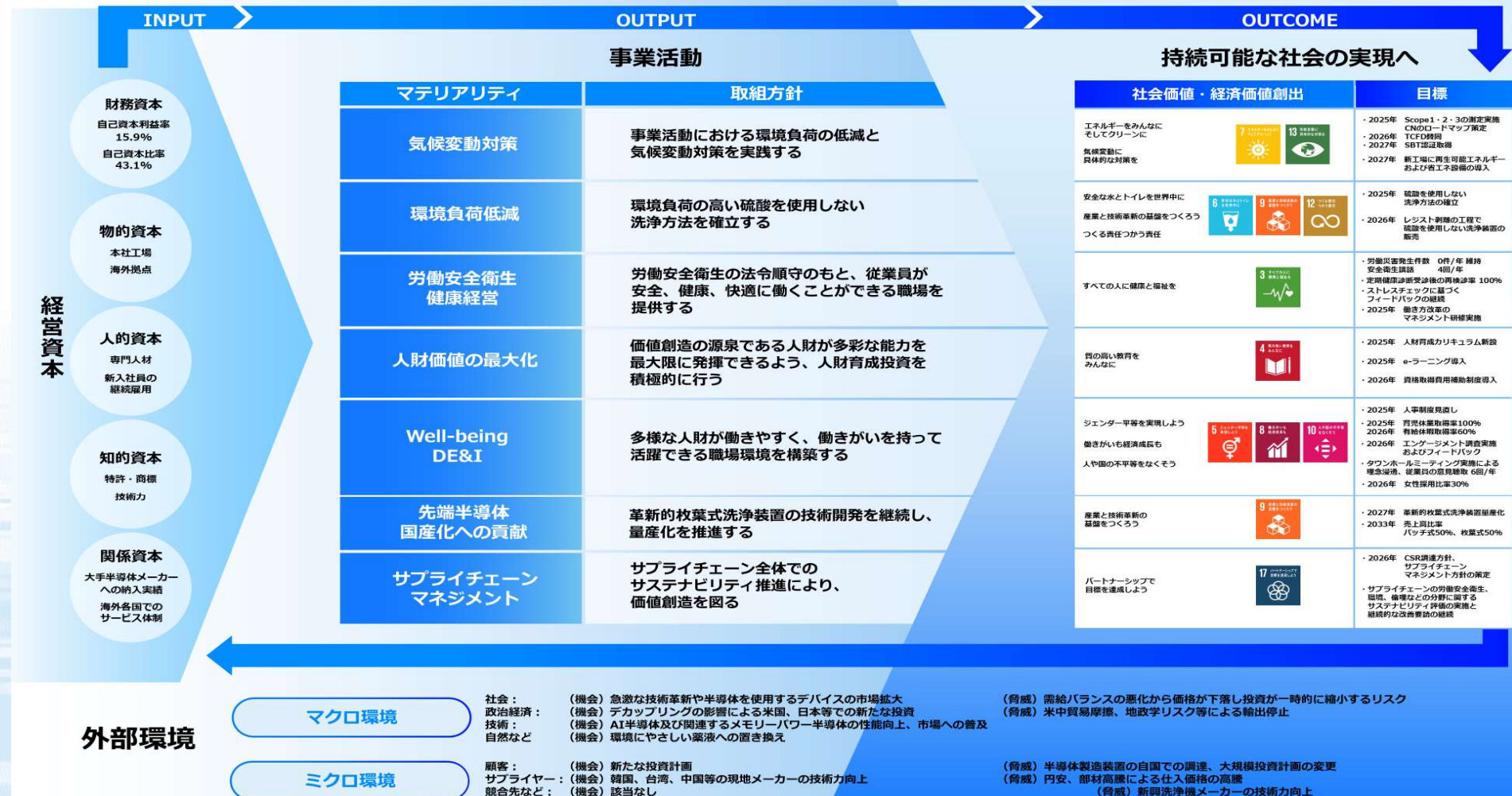
サステナビリティ経営メッセージ Sustainability management policy

半導体洗浄装置において、環境負荷の低いプロセスにて代替する洗浄装置の開発により、社会に貢献すべく尽力しております。またここ数年の売上増大に対応すべく新工場を建設予定であり、最先端技術の導入による生産性の向上、研究開発の加速を図るとともに、社会的価値への貢献として環境にやさしい地域社会との共生を実現できる工場にしたいと考えております。企業は人なりの考えのもと、2017年以降、毎年5〜7名の新卒社員を採用してきており、加えて新たな中堅社員の採用にも積極的に取り組んできました。新たな人材教育システムを含む人事制度を導入し、人材の早期戦力化を目指してまいります。

企業理念

◆ ミッション：お客様第一主義に徹し、強い会社・良い会社づくりに邁進し、人を大切に、社会貢献に努めてまいります

◆ ビジョン：技術優位の差別化された製品にて、世界市場で然るべき立場を獲得します
◆ プリンシプル：未来をつくる6つの約束（クレド）を基本に考え、行動します



マテリアリティ（重要課題）と取組方針

マテリアリティ(重要課題)	取組方針
1. 気候変動対策	事業活動における環境負荷の低減と気候変動対策を実践する
2. 環境負荷低減	環境負荷の高い硫酸を使用しない洗浄方法を確立する
3. 労働安全衛生・健康経営	労働安全衛生の法令順守のもと、従業員が安全、健康、快適に働くことができる職場を提供する
4. 人財価値の最大化	価値創造の源泉である人財が多彩な能力を最大限に発揮できるよう、人財育成投資を積極的に行う
5. Well-being・DE&I 注1)	多様な人財が働きやすく、働きがいを持って活躍できる職場環境を構築する
6. 先端半導体国産化への貢献	革新的枚葉式洗浄装置の技術開発を継続し、量産化を推進する
7. サプライチェーンマネジメント	サプライチェーン全体でのサステナビリティ推進により、価値創造を図る

注1) Well-beingとは、 ➡ 「身体的、精神的、社会的に満たされている状態」
 DE&I（ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン）とは ➡ 「多様性」を「受容・包括」し、
 それぞれに「公平」な機会提供のもとで、互いに尊重しながら成長できる環境づくりを目指した考え方

本資料の取扱上の注意

- 本資料は、2025年11月7日発表の決算短信に基づいて作成されています。
- また、本資料に記載されている業績予想、将来予測などは、当社が現時点で入手可能な情報に基づき判断したものであり、その情報の正確性、完全性を保証したり、約束したりするものではありません。また、経済動向や業界における競争、市場、諸制度などの変化により、大きく見通しが変動する可能性があります。
- 本資料に記載しております数字につきましては、単位未満切り捨てで処理しております。また、比率は四捨五入しております。

本資料に関するお問い合わせ先

株式会社ジェイ・イー・ティ
経営戦略部

TEL 0865-69-4281